開発品

MODペースト(CuALL™-Paste)

Metal Organic Decomposition Paste

省資源化・省エネルギー化に貢献するプリンテッドエレクトロニクスを促進
電子デバイス製造におけるサステナブルで新たなデザインを生み出すプロセスを推進させます

Cu金属に匹敵する導電性
Super high conductivity

低温・短時間反応
Low temperature・Short time

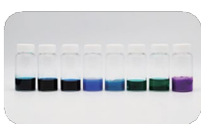
配線膜の耐酸化性
Good oxidation resistance

厚膜化可能な焼結型 耐酸化錯体銅ペースト
Thick film, Sintered type, Copper conductive Paste



低温焼結銅
original nano powder
（オリジナル微粒粉）

＋



錯体インク
MOD ink

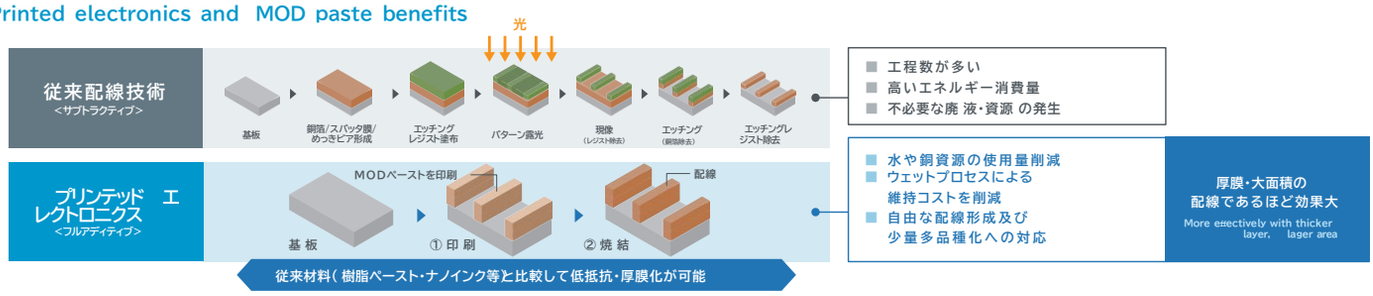
＝



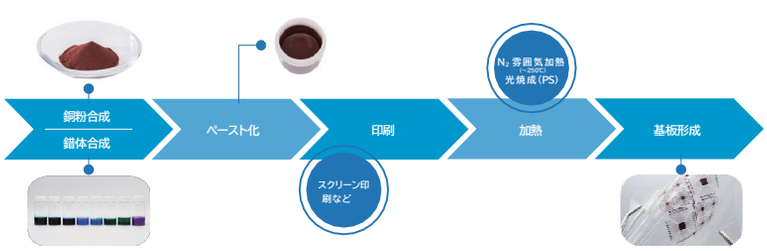
MOD
ペースト

金属結合のみの
焼結型により
導電性・放熱性が向上

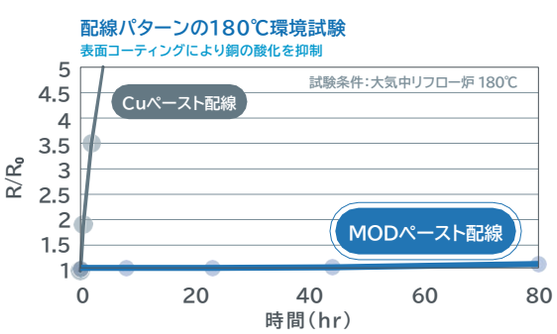
プリンテッドエレクトロニクス並びに、MODペーストの活用効果
Printed electronics and MOD paste benefits



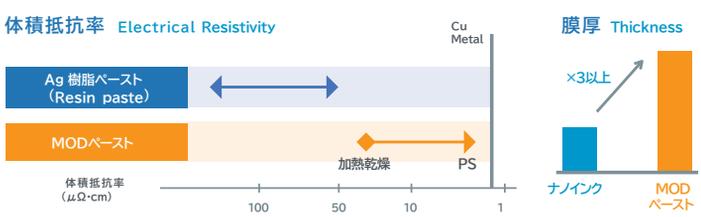
自社開発の低温焼結銅粉を活用したペースト設計、配線膜の高い信頼特性
Paste composition with our fine copper powder and MOD ink. It has unique oxidation and high reliabiliry



基板・材料技術の知見からデバイス開発をサポート使用基板：PI,FR-4,PET 等



他導電性材料に対する電気特性の優位性
Advantage of electrical property compared to other conductive materials



ソリューション提案 -大面積や自由形状デバイスの実現-
Solution



ディスプレイ等大型基板

自由形状・軽量化

プロセスコスト削減
めっき代替基板

共創によりプリンテッドエレクトロニクスを社会に浸透するパートナーを探しております
We're looking for Partners to drive Printed Electronics by co-create

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://crossmining.smm.co.jp/

X-MINING®

MINING THE FUTURE
住友金属鉱山
SUMITOMO METAL MINING